#### Substitute

## **Declaration For Patent Application**

### 特許出願宣言書

# **Japanese Language Declaration**

### 日本語宣言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が原初、最初かつ唯一の発明者(下記の氏名が一つの場合)もしくは原初、最初かつ共同発明者(下記の名称が複数の場合)であると信じています

上記発明の明細書は、						
	本書に添付されています。					
	月日					
	に提出され、米国出願番号またはPCT(特許協力条約) 国際出願番号を					
	Ł L、					
	(該当する場合) に訂正されました。					

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討 し、内容を理解していることをここに表明します。

私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されるとおり、一部継続出願情報、および一部継続出願の原出願日と 米国またはPCT国際出願日との間で出現した重要な情報 を含む、特許性の有無に関する重要な情報を開示する義務 があることを認めます。 As a below-named inventor, I hereby declare that:

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

METHOD FOR FORMING FILM, METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE, SEMICONDUTOR DEVICE AND SUBSTRATE TREATMENT SYSTEM

the specification of which					
is attached hereto.					
was filed on February 10, 2006					
as United States Application Number or PCT International Application Number					
10/56	7,733	and was amended on			
		(if applicable)			

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56, including for continuation-in-part applications, material information which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of the continuation-in-part application.

#### **Japanese Language Declaration**

(日本語宣言書)

私は、私自身の知識に基づいて本宣言書中で私が行なう表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基づく表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行なえば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

単独発明者または第 1の共同発	明者の氏名	Full name of sole or first inventor Kenichi NISHIZAWA			
発明者の署名	日付	Inventor's signature Renich Riskyai	Date October 1, 2009		
国籍		Citizenship Japan	NO		
第 2の共同発明者の氏名		Full name of second joint inventor, If any Yasuhiro TERAI			
第 2の共同発明者の署名	日付	Second inventor's signature	Date		
		Yasulina Jerai	October 1, 2009		
国籍		Citizenship Japan	1		
第 3の共同発明者の氏名		Full name of third joint inventor, If Akira ASANO	Full name of third joint inventor, If any Akira ASANO		
第 3の共同発明者の署名	日付	Third inventor's signature	Date		
		Akira Asato	October 1, 2009		
国籍		Citizenship Japan			

(OSMMN 03/2007)